

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
06. Oktober 2022 (06.10.2022)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2022/207083 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01L 21/78 (2006.01) *H01L 33/00* (2010.01)

LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2021/058318

(22) Internationales Anmeldedatum:
30. März 2021 (30.03.2021)

Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(71) Anmelder: **EV GROUP E. THALLNER GMBH**
[AT/AT]; DI Erich Thallner Str. 1, 4782 St. Florian am Inn
(AT).

(72) Erfinder: **POVAZAY, Boris**; DI Erich Thallner Straße 1,
4782 St. Florian am Inn (AT). **MOKKAPATI, Venkata**
Raghavendra Subrahmanya Sarma; DI Erich Thallner
Str. 1, 4782 St. Florian am Inn (AT).

(74) Anwalt: **SCHNEIDER, Sascha** et al.; Becker & Mül-
ler Patentanwälte, Turnstraße 22, 40878 Ratingen Nord-
rhein-Westfalen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA,
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), curasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,

(54) Title: METHOD FOR SEPARATING STRUCTURES FROM A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM TRENNEN VON STRUKTUREN VON EINEM SUBSTRAT

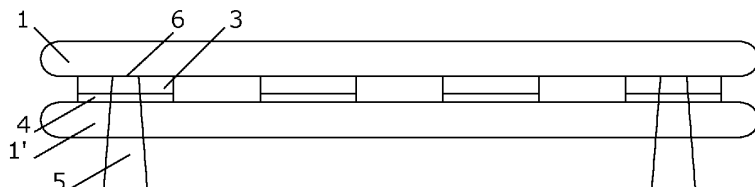


Fig. 1e

(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for separating structures from a substrate. The invention also relates to a method and a device for transferring structures from a first substrate to a second substrate.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Trennen von Strukturen von einem Substrat. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Übertragen von Strukturen von einem ersten Substrat auf ein zweites Substrat.



WO 2022/207083 A1